



*a Leiterplattenlayout, von der Bestückungsseite gesehen.
printed circuit board layout, components side view
modèle de la carte imprimée, vue du côté à équiper

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
2531 01	8	100

Verpackung: auf Rolle
Packaging: on reel
Emballage: en bobine

2531 01

Modular-Einbaukupplung, 8P8C (RJ-45), abgewinkelte Ausführung, für Leiterplatten

- 1. Temperaturbereich** -20 °C/+85 °C
- 1. Werkstoffe**
Kontaktträger PBT GF, V0 nach UL 94
Kontakt CuSn, flashvergoldet
- 2. Mechanische Daten**
Steckkraft ≤ 22,6 N
Steckzyklen ≥ 750
Kontaktierung mit Modularsteckern P 129, P 129 S
- 3. Elektrische Daten**
Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
Bemessungsstrom ≤ 1,5 A
Bemessungsspannung ≤ 150 V AC
Prüfspannung 1 kV/60 s
Isolationswiderstand ≥ 500 MΩ

2531 01

Modular chassis socket, 8P8C (RJ-45), angular version, for printed circuit boards

- 1. Temperature range** -20 °C/+85 °C
- 1. Materials**
Insulating body PBT GF, V0 according to UL 94
Contact CuSn, flash gold-plated
- 2. Mechanical data**
Mating force ≤ 22.6 N
Mating cycles ≥ 750
Mating with modular plugs P 129, P 129 S
- 3. Electrical data**
Contact resistance ≤ 20 mΩ
Rated current ≤ 1,5 A
Rated voltage ≤ 150 V AC
Test voltage 1 kV/60 s
Insulation resistance 500 MΩ

2531 01

Embase femelle modulaire, 8P8C (RJ-45), version angulaire, pour cartes imprimées

- 1. Température d'utilisation** -20 °C/+85 °C
- 1. Matériaux**
Corps isolant PBT GF, V0 suivant UL 94
Contact CuSn, doré flash
- 2. Caractéristiques mécaniques**
Force d'insertion ≤ 22,6 N
Nombre de manœuvres ≥ 750
Raccordement avec connecteurs modulaires mâles P 129, P 129 S
- 3. Caractéristiques électriques**
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Courant assigné ≤ 1,5 A
Tension assignée ≤ 150 V AC
Tension d'essai 1 kV/60 s
Résistance d'isolement 500 MΩ